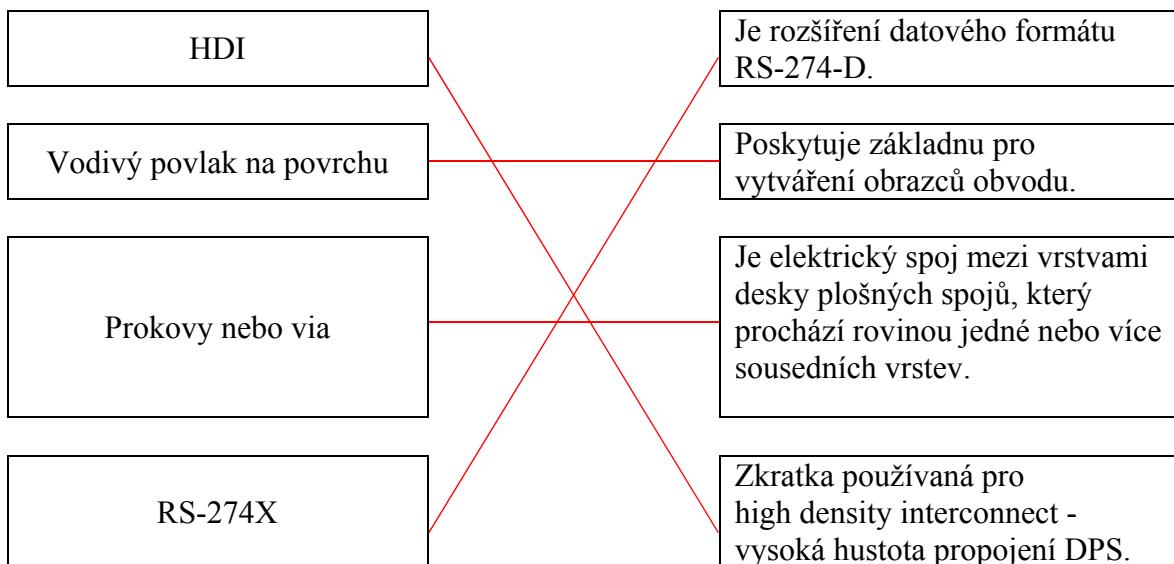


1. Přiřaďte pojmy z levého sloupce příslušným definicím vpravo.



2. Uveďte tři základní charakteristiky desek plošných spojů s vysokou hustotou propojení.

1. Vyšší hustota spojů na jednotku plochy než u běžné desky plošných spojů.
2. Mají jemnější linie a mezery.
3. Mají menší prokovy, uchycovací plošky prokovů a velmi vysokou hustotu připojovacích plošek.

3. Upravte text tak, aby následující tvrzení byla pravdivá.

Napájecí vývody by měly být odděleny od zemnící roviny pomocí ~~(indukčnosti keramických kondenzátorů)~~ umístěných co nejbliže k napájecím vývodům integrovaného obvodu.

Obecně jsou frekvence vyšší než $(\frac{1 \text{ GHz}}{1 \text{ MHz}})$ považovány za vysoké frekvence.

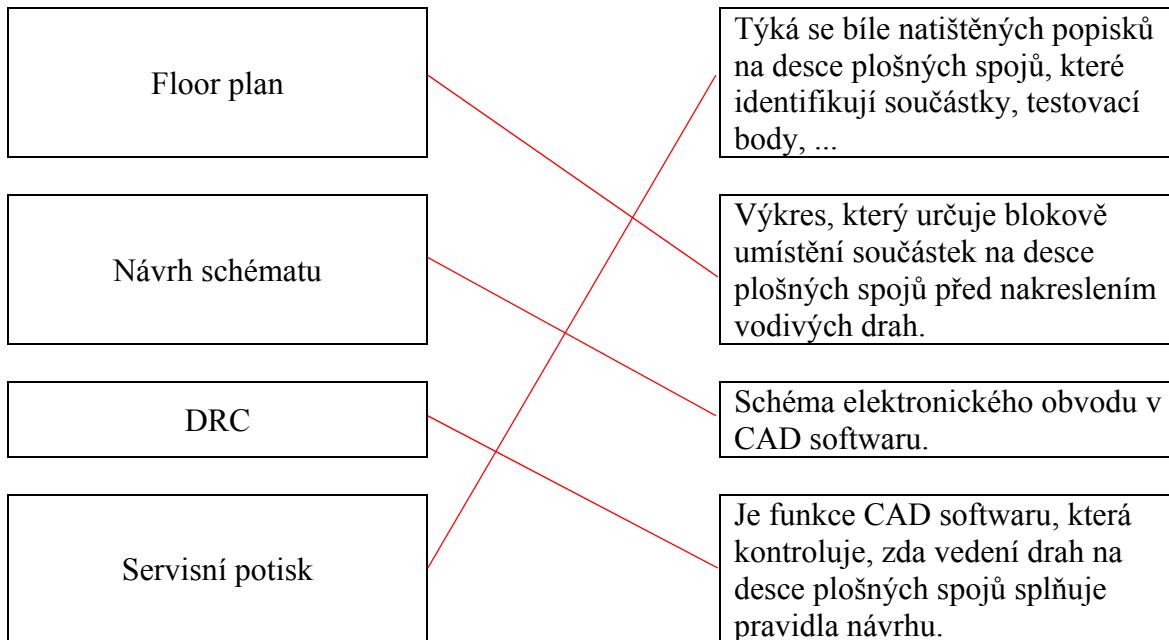
Jednovrstvé desky plošných spojů jsou vyrobeny z jediné vrstvy ~~(základního materiálu nebo podložky pryskyřice)~~.

Desky plošných spojů s hliníkovým jádrem jsou složeny z $(\frac{\text{Au}}{\text{Al}})$ jádra, vysoko tepelně vodivé dielektrické vrstvy a standardních vrstev obvodu.



Tuhé-ohebné desky plošných spojů kombinují (^{nejhorší}_{nejlepší}) z obou tuhých desek a ohebných obvodů sloučených dohromady.

4. Přiřaďte pojmy z levého sloupce příslušným definicím vpravo.



5. Uveďte alespoň 5 základních kroků při výrobě desky plošných spojů

1. **Vytvoření předlohy**
 2. **Vrtání**
 3. **Leptání**
 4. **Nepájivá maska**
 5. **Servisní potisk**
-

6. Upravte text tak, aby následující tvrzení byla pravdivá.

Udržujte digitální a analogové země (^{spojené}_{oddelené}), protože napěťové a proudové špičky z (^{analogových}_{digitálních}) obvodů mohou generovat rušivý šum v (^{digitálních}_{analogových}) obvodech.

Když umisťujete součástku, $\left(\begin{array}{l} \text{co nejvíce zkraťte} \\ \text{eo nejvíce prodlužte} \end{array} \right)$ délku vodivé dráhy a vyhněte se vedení dráhy pod úhlem $\left(\begin{array}{l} 90 \\ 45 \end{array} \right)$.

Výrobci používají $\left(\begin{array}{l} \text{foto plotr} \\ \text{tiskárna} \end{array} \right)$ k vytvoření $\left(\begin{array}{l} \text{digitálního} \\ \text{negativního} \end{array} \right)$ obrazu desky plošných spojů.

Citlivé signály by se měly $\left(\begin{array}{l} \text{držet mimo} \\ \text{odstínit} \end{array} \right)$ od zdrojů šumu k tomu určenými rovinami a měly by být zachovány jako impedančně řízené.

